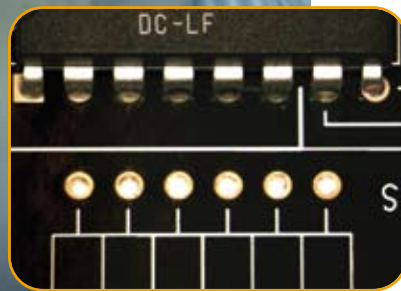


ALPHA® Vaculoy® SACX® 0807 无铅波峰焊接合金

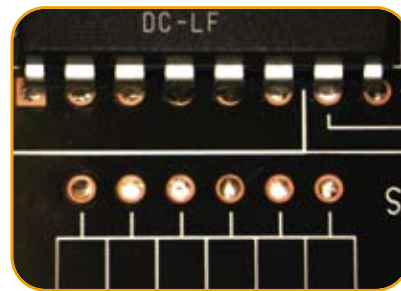
使用低银合金
可获得高焊接可靠性和像 SAC305 般性能

ALPHA® Vaculoy® SACX® 0807:

- 于复杂的双面印刷电路板组件上提供高焊接性能
- 低表面张力，可实现快速润湿，有利于获得优秀的填孔性能和降低表面组装相关的缺陷
- 低铜溶蚀率，在高温和长接触时间过程（包括返工）期间，减少溶蚀机会发生
- 为低锡渣率而设计



ALPHA® SACX® 0807



Sn/Cu/Ni



alpha



Cookson Electronics

ALPHA® Vaculoy® SACX® 0807 无铅波峰焊接合金

ALPHA® Vaculoy® SACX® 0807 与 SAC305 的工艺成本比较：

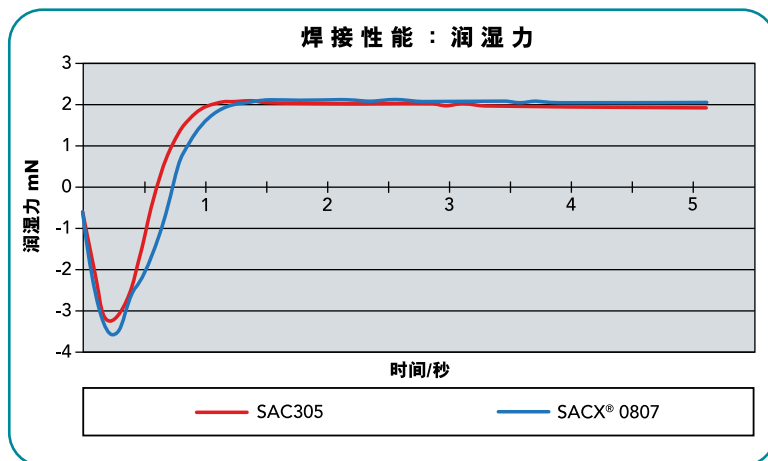
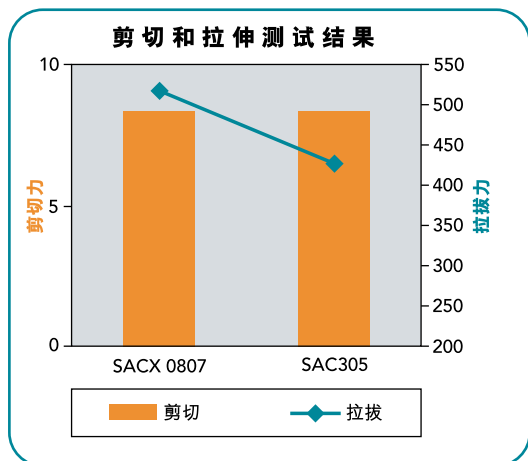
- 低银含量，更低材料成本
- 低操作温度要求，有利于降低能源成本
- 低锡渣率，有利于提高合金利用率和减少浪费

ALPHA® Vaculoy® SACX® 0807 添加剂有助于提高焊接强度和可靠性，与 SAC305 相似

使用低银合金
可获得高焊接可靠性和像 SAC305 般性能

ALPHA® Vaculoy® SACX® 0807 提供极佳的填孔性能：

- 润湿性能与 SAC305 几乎相同
- 高润湿力
- 低表面张力可实现更快的润湿效果
- 更快的润湿效果意指更佳的填孔性能



同时提供 ALPHA® SACX-0800 补充合金

性能摘要

工艺效益	ALPHA® Vaculoy® SACX® 0807	性能表现	客户效益
波峰焊接工艺	产量	产量与行业标准的 Vaculoy® SAC305 类似，比锡/铜/镍合金更优越	更低的返工和返修成本
	润湿速度	0.07 秒的润湿速度与工业 Vaculoy® SAC305 的性能类似 (0.06 fpr)	高产量和良率
	接触时间，锡炉温度和传送速度	接触时间：2.0 - 5.0 秒；锡炉温度：255 - 265°C；传送速度：0.8 - 1.5m/min (2.6 - 5.3 ft/min)	宽阔的波峰焊接工艺窗口
工艺维护	锡渣产生	低锡渣产生率，与 SAC305 相比低 50%	更少的焊废料
	铜溶蚀率	与行业标准 SAC305 相比更低的铜溶蚀率	合金监控成本更低
焊点可靠性	表面安装器件剪切强度	表面安装器件剪切强度与行业标准 Vaculoy® SAC305 类似	相同的可靠性，更低的成本
	通孔拉引强度	表面安装器件拉引强度与行业标准 Vaculoy® SAC305 类似	相同的可靠性，更低的成本
	热循环	与行业标准 Vaculoy® SAC305 的结果相同	可接受的产品寿命指标